江苏芯丰集	成电路封装压焊图	图号:314BD017	版本	A. 0				
贴片方向(芯片与片环方向示意图)	框架传输进料方向第一个孔为椭圆孔	备注及特殊要求(Remark&Special Instruct框架到芯片最高点的线弧高度<600um居中装片	ion)					
VSS 16 9 VDD 1 50 8 i请仔细核对焊线位置,以及材料选择。如天请签字回传,谢谢! 客户回签:								
顶针 点胶 点胶 /	方式 如选择UV膜 请确认 □ UV膜 风险监							

					台/日益:					
单顶针	i针 多顶针 /	点胶 ^{点胶}	方式 画胶 /	如选择UV膜 请确认 产品是否可以照 射紫外线, 如不能请讲明	UV膜 ■ 蓝膜 □ DAF膜	风险监控: 低风险				
	l 品型号 ct Type)	HS16F3211W		线 材 直 径 (Wire Diameter)		银合金线0.8mil	芯片减薄厚度 Chip thinning thickness 300±10um)um	
1	片名称 ·Name)	HS5130		压焊点尺 (Pad Openi		60X60um	装片胶 Epoxy	首选	9246LB5(-	寻电胶)
	尺寸 e Size)	1. 002X0. 598mm		最小压焊间 (Min Pitch	1)	78um	(二选一)	备选	/	
	形式 ge Type)	SOP16L (9. 9×3 . 9×1 . 4 e=1. 27)		先 焊 约 (Wire Bond S		PIN16	塑封料 Molding	首选	EMC-GR710)F GN
	线 框 Frame)	SOP16L(12R)(80×80) -H		焊 线总 (Quantity of	数 Wire)	17	Compound (二选一)	备选	/	
	.镀方式 ating Type)			最长线长/总 (Length of		/19.834mm	CUP/BOAC		YES	NO NO
	·/切割方式 e/Cutting Mode)	8寸/刀片开槽 +刀片切割		顶层铝厚度 (Top aluminum thickness)		0.8um(3层)	RF 芯片		YES	NO
吸 (suction	嘴 nozzle)	RT-020-030-FT		切割道(Cutting	g Way)	60um	LOW-K芯片		YES	NO
拟制 Pr	epared by	顾馨 2024.8.7		审核 Checke	d by	李佳欣	批准 Approved by 周建军		周建军	